

OMNIMATE Housing - Serie CH20M CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



FE-Kontakt

Funktionssicherheit - entweder voll integriert oder einfach montiert

Der optionale Anschluss „CH20M FE“ schützt ihr System optimal durch einen Tragschienenkontakt für die Funktionserdung.

- Der im 6-mm-Gehäuse vormontierte Funktions-Erde-Kontakt ermöglicht eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung von elektronischen Abschirmungen der elektronischen Schaltung zur Tragschiene (bspw. „CH20M6 BP 4P-4P FE BK“, 1164650000“)
- Für die Gehäuse von 12,5 bis 67,5 mm steht ein Funktions-Erde-Kontakt zur Verfügung, der im Reflow-Verfahren gemeinsam mit den Stiftleisten und einem optionalen Buskontakt vollautomatisch verarbeitet werden kann. Die Position der Leiterplatte im Gehäuse gibt die Stiftlänge 1,5 mm / 3,2 mm vor

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
Best.-Nr.	1189370000
Ausführung	Elektronikgehäuse, Zubehör, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 1, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, verzinkt, Tape
GTIN (EAN)	4032248972715
VPE	750 Stück
Produkt-Kennzahlen	UL:
Verpackung	Tape

OMNIMATE Housing - Serie CH20M CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,482 g

Werkstoffdaten

Kontaktoberfläche verzinkt

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC002637	ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-18-92-90
eClass 7.1	27-18-92-90	eClass 8.1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90

Hinweise

Hinweise

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Engineering-Daten [STEP](#)

Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

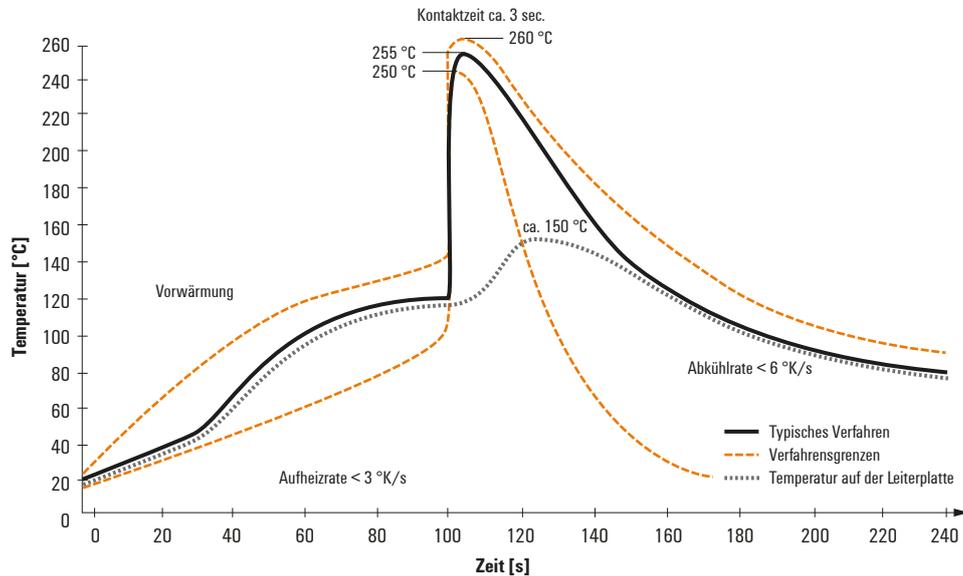
Germany

Fon: +49 5231 14-0

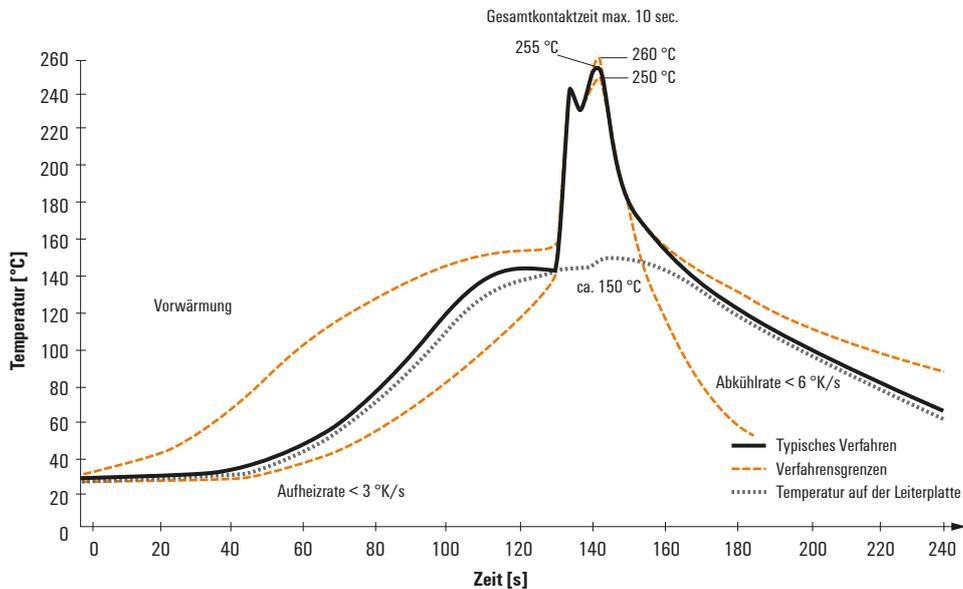
Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

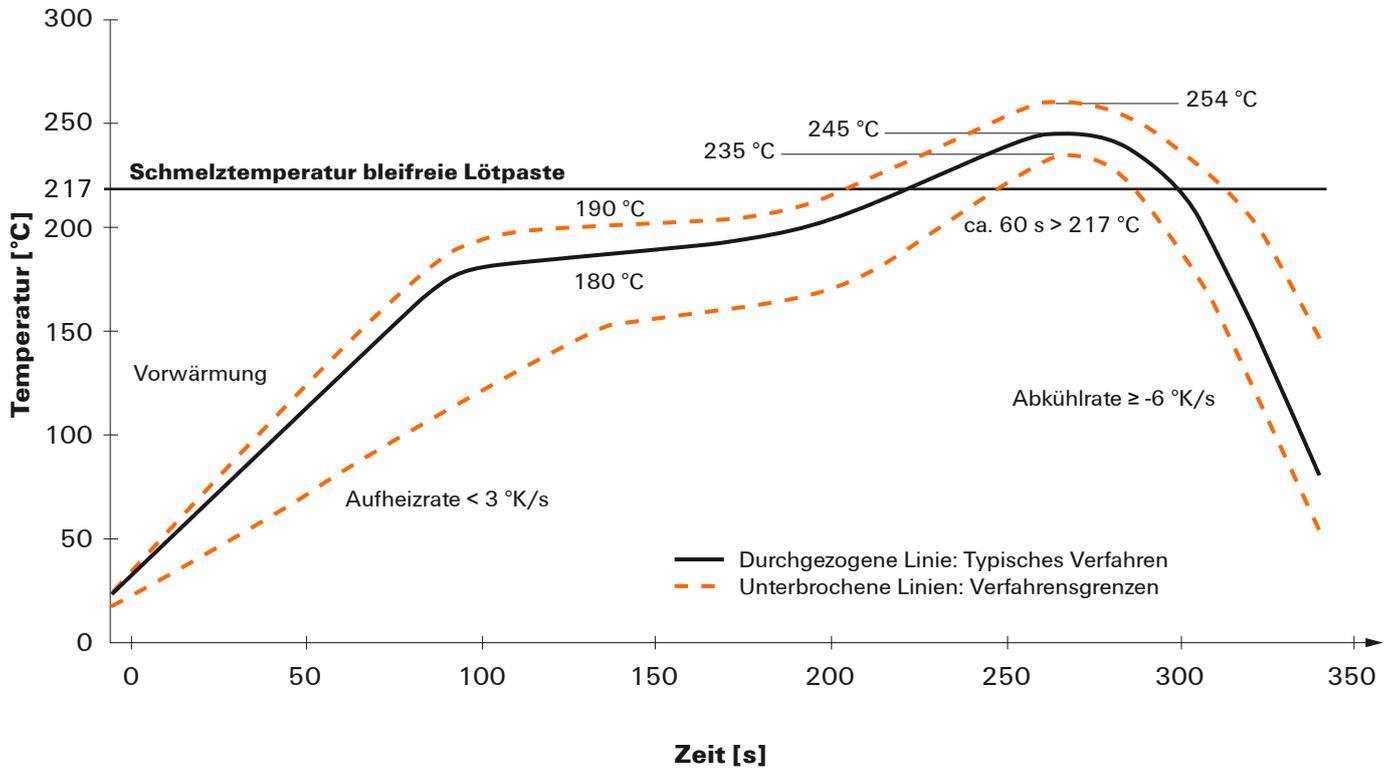
Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste ‚aktiviert‘. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.